DIN EN IEC 62148-21

DIN

ICS 33.180.20

Entwurf

Einsprüche bis 2021-08-04
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN IEC 62148-21:2020-02

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und Geräte – Gehäuse- und Schnittstellennormen – Teil 21: Konstruktionsleitfaden für elektrische Schnittstellen von PIC-Gehäusen mit Si-Feinraster-Ball-Grid-Array (S-FBGA) und Si-Feinraster-Land-Grid-Array (S-FLGA) (IEC 86C/1684/CDV:2020); Englische Fassung prEN IEC 62148-21:2020

Fibre optic active components and devices –
Package and interface standards –
Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)
(IEC 86C/1684/CDV:2020);
English version prEN IEC 62148-21:2020

Composants et dispositifs actifs fibroniques –
Normes de boîtier et d´interface –
Partie 21: Guide de conception de l´interface électrique des boîtiers PIC utilisant des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA)
(IEC 86C/1684/CDV:2020);
Version anglaise prEN IEC 62148-21:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-06-04 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE oder Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

AVA Documents Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 62148-21:2021-07

Nationales Vorwort

Die Englische Fassung des europäischen Dokuments prEN IEC 62148-21:2020-09 "Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und Geräte – Gehäuse- und Schnittstellennormen – Teil 21: Konstruktionsleitfaden für elektrische Schnittstellen von PIC-Gehäusen mit Si-Feinraster-Ball-Grid-Array (S-FBGA) und Si-Feinraster-Land-Grid-Array (S-FLGA)" (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale Dokument IEC 86C/1684/CDV:2020-09 "Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)" unverändert in den Entwurf prEN IEC 62148-21:2020-09 übernommen worden.

Das internationale Dokument wurde vom IEC/SC 86C "Fibre optic systems and active devices" der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC. Das Dokument wurde den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur "JA/NEIN"-Entscheidungen möglich, wobei "NEIN"-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 412.2 "Komponenten für Kommunikationskabelanlagen" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des Beschlusses des Technischen Beirats Internationale und Nationale Koordinierung (TBINK) der DKE vom 17.09.2020 nur die englische Fassung von IEC 86C/1684/CDV:2020-09.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. IEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN EN IEC 62148-21:2020-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 62148-21:2021-07

a) Die Festlegung eines elektrischen Schutzbandbereichs um den optischen Anschlussbereich, um Anwendungen mit elektrischen Signalen bei höheren Symbolraten (z. B. 50 Gbaud und 100 Gbaud) zu ermöglichen.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 62148-21:2021-07

E DIN EN IEC 62148-21:2021-07
prEN IEC 62148-21:2020

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS – Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)

Contents

Page

1 Scope 5
2 Normative references 5
3 Terms and definitions 5
4 Terminal position numbering 5
5 Code of package nominal dimensions 6
6 Symbols and drawings 6
7 Dimensions and tolerances 8
Bibliography 13

Figures

Figure 1 – S-FBGA and S-FLGA outline 7
Figure 2 – Mechanical gauge drawing 8
Figure 3 – Array of terminal-existence areas 8

Tables

Table 1 – Dimensions and tolerances 9
Table 2 – Combination list of D, E, M_D, and M_E for e = 0,30 mm pitch S-FBGA (informative) 11
Table 3 – Combination list of D, E, M_D, and M_E for e = 0,25 mm pitch S-FLGA 12

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 62148-21:2021-07